附件1：

**后立项后补助项目指南**

1、**项目任务：**电子级多晶硅材料研发

**项目编号：**2018ZX02404

**项目类别：**材料技术研发

**项目目标：**根据2014年发布的电子级多晶硅材料研发项目指南，针对40nm集成电路用12英寸硅单晶产品要求，研究开发电子级多晶硅生产技术，提升产品品质。(1)产品纯度高于11N；本征基磷电阻率高于500 Ohmcm, 本征基硼电阻率高于5000 Ohmcm；碳含量低于80ppba；体金属总含量小于1.5ppbw；表面金属含量要求：Fe小于0.25ppba、Cu小于0.025 ppba、Ni小于0.04 ppba、Cr小于0.045 ppba、Zn小于0.09 ppba、Na小于0.98 ppba、Al小于0.52 ppba、K小于0.43 ppba；(2)通过硅片生产企业产品验证考核与供应商资质认证，签订长期供应合同，集成电路硅片用多晶硅年销售不低于200吨。

现公开征集项目成果，进行后立项后补助。符合以上要求的单位，均可提出申请，由专项办组织专家进行审核评价，对达到要求的单位进行补助。

**项目承担单位要求：**中国大陆境内注册的、具有独立法人资格的多晶硅制造企业。技术研发应在中国大陆境内完成。

**组织实施方式：**公开征集，择优支持

**资金来源：**中央：地方：企业=1:0:0 后立项后补助

**项目数据统计周期：**2014年1月1日-2017年7月30日

2、 **项目任务：**先进装备与材料在AMOLED领域中的应用开发

**项目类别：**装备技术研发

**项目编号：**2018ZX02604

**项目目标：**根据2014年发布的先进装备与材料在AMOLED领域中的应用开发项目指南，基于 02专项在集成电路装备、材料等领域研发取得的相关技术，支持在G4.5及以上AMOLED等新型显示领域开发应用，推动新型显示装备、材料开发应用，提升显示产业创新能力。(1)针对新型显示领域对光刻机、刻蚀机、PVD、CVD、清洗机、激光退火等要求，联合集成电路装备企业开展相关技术的应用开发及工艺验证，用户考核，形成批量制造能力并实现销售。(2)联合集成电路靶材、特种气体、显影液、刻蚀液、光刻胶等关键材料企业，进行相关技术的应用开发及工艺验证，通过用户考核，实现关键材料的长期供货。

现公开征集项目成果，进行后立项后补助。符合以上要求的单位，均可提出申请，由专项办组织专家进行审核评价，对达到要求的单位进行补助。

**项目承担单位要求：**中国大陆境内注册的、具有独立法人资格的平板显示产品制造企业。技术研发应在中国大陆境内完成。

**组织实施方式：**公开征集，择优支持

**资金来源：**中央：地方：企业=1:0:0 后立项后补助

**项目数据统计周期：**2014年1月1日-2017年7月30日